

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-017

## 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投 资协议书》暨终止原投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：强一半导体探针卡制造基地项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：约人民币 10 亿元，其中固定资产投资约人民币 2.3 亿元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、土地、规划、环评、建管等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次拟签订的投资协议书所涉及的项目用地需按照国家法律法规和有关政策规定的用地程序办理，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本项目投资是为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，但行业的发展趋势及市场需求的变化等均存在一定的不确定性，未来项目是否能达到

预期效益具有不确定性。

4、本项目主要资金来源为公司及合肥子公司自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。另外，如果本项目通过银行贷款筹资，项目建成后却未能取得预期的经济效益，则公司还会面临较大的偿债风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次交易概况

为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司与合肥经济技术开发区管理委员会就投资建设强一半导体探针卡制造基地项目达成合作意向，拟签订《投资协议书》（以下简称“本协议”）。同时，双方于2022年3月1日签订的强一半导体探针卡项目《投资协议书》及其补充协议（以下简称“原协议”），自本协议生效之日起自行终止，该协议项下未履行的内容不再履行，且双方均免于承担因此产生的责任。本项目预计投资总额为人民币10亿元，包含土地购置、厂房建设及装修、设备购置及安装等，其中固定资产投资约人民币2.3亿元（具体以实际投资额为准），预计用地面积约48亩（具体面积以实际测量为准），项目规划产品为集成电路晶圆测试核心硬件探针卡，强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥子公司”）及公司未来在合肥经济技术开发区新设立一家或多家独立核算、自负盈亏的法人单位（或有）共同作为本项目实施主体。资金来源为公司及合肥子公司的自有、自筹资金。

### （二）原协议终止原因

鉴于原协议项下租赁场地的现有条件（包括场地面积及承重结构等）已无法满足公司当前产能扩充及未来安全生产的硬性要求，故公司拟通过另行选址建设

生产基地。

### （三）本次交易审批程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

### （四）是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、交易对方的基本情况

名称：合肥经济技术开发区管理委员会

地址：安徽省合肥经济技术开发区翡翠路 398 号

合肥经济技术开发区管理委员会与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

## 三、投资标的的基本情况

### （一）投资标的概况

本次拟投资建设强一半导体探针卡制造基地项目。基于合肥区位优势，公司前期通过租赁方式快速响应客户需求。为进一步提升对核心客户的配套服务能力与供应稳定性，本项目拟通过建设自有厂房，打造贴身服务、快速响应的先进探针卡生产基地，巩固并扩大公司在主营业务领域的市场份额。

### （二）投资标的的具体信息

### 1、项目基本情况

投资类型	投资新项目
项目名称	强一半导体探针卡制造基地项目
项目主要内容	集成电路晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售
建设地点	合肥经济技术开发区综合保税区（以下简称“经开区”）云谷路以北综保大道以西。
项目总投资金额	约人民币 10 亿元，其中固定资产投资约人民币 2.3 亿元（具体以实际投资额为准）
项目建设期	计划 2026 年 5 月开工建设，预计 2027 年 5 月建成投产
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 2、各主要投资方出资情况

本项目不涉及其他投资方，公司及合肥子公司作为投资方，拟以自有资金、自筹资金建设投资项目，投资总额约为人民币 10 亿元（具体以实际投资额为准）。

### 3、项目目前进展情况

本项目目前处于筹备的关键阶段，核心团队正按计划推进各项工作。本次对外投资事项经股东会审议通过后，公司将尽快推进与政府部门投资协议书的签署工作，明确项目落地事宜。

### 4、项目市场定位及可行性分析

公司现有租赁场地因面积及承重结构限制，已无法满足扩产及未来安全生产要求。本次投资已与当地管委会达成合作意向，将在扶持政策、审批流程等方面获得有力支持。本项目建成后，将有效解决产能瓶颈，充分利用合肥市集成电路产业集群优势，贴近下游客户需求，提升产品交付效率和属地化服务能力，进一步巩固公司在华东市场的核心竞争力。

#### （三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司及合肥子公司自有资金、自筹资金，不涉及募集资金。

## 四、投资协议的主要内容

### （一）协议主体

甲方：合肥经济技术开发区管理委员会

乙方：强一半导体（苏州）股份有限公司

### （二）投资项目内容

1、项目选址：合肥经济技术开发区综合保税区云谷路以北综保大道以西

2、占地面积：约 48 亩（具体面积以实际测量为准）。乙方竞买成功后，须按成交价在土地成交后 10 个工作日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》并按规定及时缴纳出让金和契税。

3、投资总额：约人民币 10 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元

4、投资主要内容：集成电路晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售

5、项目计划建设周期：2026 年 5 月开工建设，预计 2027 年 5 月建成投产

6、项目实施主体：合肥子公司及公司未来在经开区新设立一家或多家独立核算、自负盈亏的法人单位（或有）共同作为项目实施主体（以下简称“项目公司”）。合肥子公司实缴注册资本金 1 亿元人民币。项目公司成立后将自动承接乙方在本协议书项下的所有权利和义务，乙方就项目公司在本协议项下的义务向甲方承担连带责任。

### （三）合作双方主要权利和义务

1、甲方承诺协助乙方及项目公司办理相关环节审批，包括但不限于场地清障；办理交地手续；基础设施申报；规划设计、土地、环保、建设等环节的审批手续。

2、乙方取得土地使用权后，按照约定时间开工建设，按时建成投产，按照约定完成相关经济指标要求。

#### （四）特别约定

1、乙方应当按本投资协议及与自然资源和规划主管部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》的约定使用项目土地，乙方若违反投资协议约定或不按规划部门批准的建设内容建设，私自改变土地用途，自然资源和规划主管部门有权无偿收回土地使用权、该地块上所建的建筑物无偿归甲方所有。

2、乙方如造成项目土地闲置，闲置满1年不满2年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满2年且未开工建设的，自然资源和规划主管部门有权无偿收回国有建设用地使用权。

项目按约定日期开工建设，但已开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足25%，中止开发建设满一年的，也可以认定为闲置土地，将按照土地转让合同总价款的20%征收土地闲置费，并要求限期开发建设。

3、乙方如违反协议约定，在未征得甲方同意的情况下，在完成固定资产投资并投产前将名下的土地使用权、建筑物全部或部分转让给第三人，甲方有权解除本协议，自然资源和规划主管部门收回土地使用权，地上附属物补偿双方应协商处理。

4、乙方自愿承诺未经甲方书面同意，乙方不对所持项目公司的股权进行转让、置换、质押、抵押等处置行为（乙方为项目公司经营发展或融资需要，对所持项目公司股权进行质押、抵押的，应在处置前15日书面请示甲方，甲方无正当理由不得拒绝；乙方转让项目公司股权的，应确保受让方继续履行本协议项下乙方的全部义务，且股权受让方符合园区产业定位，甲方应在收到书面请求后10日内出具是否同意的书面意见，逾期未答复视为同意），项目公司如需增减股东应本着有利于项目公司业务拓展、本项目实施的原则。

5、乙方在项目建设和实施过程中，应接受经开区建管部门的监督。在规划、土地利用、环保、能耗、安全等方面确保符合国家、安徽省、合肥市以及经开区的相关标准要求。如乙方在项目建设和实施过程中存在重大违法行为导致项目终止，则甲方有权解除本协议，自然资源和规划主管部门无偿收回土地使用权，地上附属物不予补偿或赔偿。

6、如遇国家税收政策调整、重大灾害等因素，或因土地供应、规划审批等非乙方因素造成项目进度滞后，影响乙方如期开工、建设、投产运营进度等的，经甲乙双方协商一致后，双方可就有关进度、产出指标进行顺延，双方可另行签署补充协议。

7、乙方如将项目宗地内厂房、空地对外租赁，须保证实现本协议约定的纳税目标，租赁对象须符合园区产业定位，并向甲方报备。

8、甲乙双方于 2022 年 3 月 1 日签订的强一半导体探针卡项目《投资协议书》及其补充协议，自本协议生效之日起自行终止，该协议项下未履行的内容不再履行，且双方均免于承担因此产生的责任。

#### （五）争议解决

因履行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

#### （六）合同生效条件

自双方签字盖章、项目用地通过合肥市土地管理委员会批准且乙方依法获得土地使用权之日后生效。

### 五、本次投资对公司的影响

本项目建成后，可有效解决原有厂区场地面积不足、建筑承重结构无法满足扩产条件和未来安全生产要求等瓶颈问题，进一步释放产能，并充分利用合肥市

集成电路产业集群优势，提升产品交付效率和属地化服务能力，巩固并逐步扩大公司在主营业务领域的市场份额。此举是公司深化产业布局、优化资源配置、实现可持续高质量发展的重要举措，有助于增强公司核心竞争力和行业影响力。

本次投资计划拟使用公司自有资金或自筹资金，短期内将面临一定的资金投入压力，可能导致货币资金减少、投资活动现金流出增加。长期来看，随着项目逐步建成并投入运营，将逐步释放产能、产生经营收益，为公司带来营业收入和利润增长点，提升盈利能力与资产回报率。公司将合理规划资金使用节奏，保障项目建设和日常运行的有序开展。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、本次投资的风险分析

### （一）项目审批与合规风险

本项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、土地、规划、环评、建管等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

### （二）土地获取风险

本次拟签订的投资协议书所涉及的项目用地需按照国家法律法规和有关政策规定的用地程序办理，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

### （三）行业发展及需求波动风险

本项目投资是为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，但行业的发展趋势及市场需求的变化等均存在一定的不确定性，未来项目是否能达到预期效益具有不确定性。

### （四）资金筹措与偿债风险

本项目主要资金来源为公司及合肥子公司自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。另外，如果本项目通过银行贷款筹资，项目建成后却未能取得预期的经济效益，则公司还会面临较大的偿债风险。

公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月10日